

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用関連会社）を取り巻く事業環境は、海外では、世界的な原油価格の高騰、米国での金利の上昇などの影響により、米国や中国の景気拡大に減速傾向が表れたものの、概ね好調に推移いたしました。国内においても、オリンピック終了後から多少勢いは落ちたものの、デジタルAV機器を中心に個人消費は増え続け、企業のIT投資も改善に向かうなど、緩やかな成長を続けております。

IT産業においては、ユビキタス社会が新しいステージに移りつつあります。当中間期もデジタルAV機器の需要はさらに拡大し、広く普及し始めました。しかしながら、オープンな技術の中での競争は激しく、個々の製品の競争力の違いによって事業の成否が顕著に表れるようになりました。

こうした状況の中で、売上高は2兆2,200億円（前年同期比3.6%増）（受注高：1兆4,105億円〔前年同期比8.2%増〕、当社単独ベース）となりました。ソフトウェア・サービスは微増にとどまりましたが、第3世代携帯電話用基地局や新紙幣対応の金融端末装置のほか、デジタルAV機器向けロジックLSIやHDD（小型磁気ディスク装置）も好調でした。

損益につきましては、営業利益は332億円（前年同期比512億円増）となりました。ソフトウェア・サービスでは販売価格の下落の影響、採算性の悪化したプロジェクトに関する損失などにより減益となったものの、プラットフォームと電子デバイスでは売上の増加とコストダウンの効果により前年同期の赤字から益転し主要3セグメント全てで利益を計上いたしました。

経常利益は40億円（同717億円増）となりました。営業利益の改善に加え、営業外損益では、有利子負債の減少等で金融収支が34億円、前年度の株価の上昇や代行返上により退職給付積立不足償却額が92億円、また、持分法による投資利益も41億円の改善となりました。米AMD社とのフラッシュメモリ合弁会社や仏アルカテル社との海外向け第3世代携帯電話基地局の合弁会社の損益が改善し、株式の売却によるファナック社の持分法適用関連会社からの離脱の影響を吸収いたしました。そのほか、為替差額も63億円改善いたしました。

この結果、中間純損益は81億円の損失（前年同期は585億円の損失）となりました。

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

1. 事業の種類別セグメント

a. ソフトウェア・サービス

ソフトウェア・サービスの売上高は、国内は6,677億円（前年同期比0.5%減）（国内向け受注高：5,300億円〔前年同期比4.5%増〕、当社単独ベース）、海外は2,487億円（前年同期比4.6%増）となりました。全体では、9,165億円（同0.8%増）となりました。

なお、ソフトウェア・サービスの売上高は、前年度の海外事業の再編による影響を除くと、前年同期比で2.0%の増加となります。

国内ではソリューションサービス／システムインテグレーションサービスが価格低下圧力などにより売上が伸び悩みましたが、海外では、前年度に政府系アウトソーシング商談を連続して受注した英国の富士通サービスの売上高が伸びました。

営業利益は155億円（同133億円減）となりました。米国の富士通コンサルティングが前年度の事業構造改善効果、英国の富士通サービスが政府系大型アウトソーシング商談の増収効果により、それぞれ前年同期から改善いたしました。しかしながら、国内のソリューションサービス／システムインテグレーションサービスでは、前年度より引き続いた価格低下圧力に対してコストダウンが及ばなかったほか、採算性の悪化したプロジェクトに関して新規および追加の損失が発生し、前年同期比で減益となりました。

b. プラットフォーム

プラットフォームの売上高は、国内は5,523億円（前年同期比9.4%増）（国内向け受注高：5,405億円〔前年同期比3.0%増〕、当社単独ベース）、海外は2,355億円（前年同期比7.7%増）（海外向け受注高：1,609億円〔前年同期比26.8%増〕、当社単独ベース）となり、全体では7,879億円（前年同期比8.9%増）となりました。

国内では第3世代携帯電話用基地局や新紙幣対応の金融端末装置の売上が好調であり、高品質で高信頼の製品が市場から評価されたHDD（ワールドワイド生産台数：850万台〔前年同期比53.7%増〕）も売上が増加いたしました。一方、パソコン（ワールドワイド出荷台数：324万台〔同16.5%増〕）の売上は微増にとどまり、携帯電話（出荷台数：153万台〔同14.0%減〕）は出荷台数、売上高とも前年同期を下回りました。

営業利益は37億円（前年同期比244億円増）となりました。携帯電話用基地局、金融端末装置等の増収効果やサーバ、IPネットワーク機器や光伝送システムのコスト削減により収益が改善いたしました。携帯電話は売上が低迷した上に高機能化に伴いコストが増加したことにより収益が大幅に悪化いたしました。

c. 電子デバイス

電子デバイスの売上高は、国内は2,199億円（前年同期比33.6%増）（国内向け受注高：1,215億円〔前年同期比20.5%増〕、当社単独ベース）、海外は1,735億円（前年同期比2.0%増）（海外向け受注高：550億円〔同38.1%増〕、当社単独ベース）となり、全体では3,935億円（前年同期比17.6%増）となりました。

ディスプレイではLCD（液晶ディスプレイパネル）が価格下落により前年同期に比べ減収となったものの、デジタルAV機器向けロジックLSIや電子部品系子会社の売上が引き続き好調でした。

営業利益は345億円（同357億円増）となりました。ロジックLSIや電子部品系子会社の増収とコストダウンの進展により大幅な利益増となりました。一方、PDP（プラズマディスプレイパネル）では、価格低下影響で利益が大きく減少したほか、LCDも第2四半期に入り市況が急激に悪化し、利益が減少いたしました。

d. その他

その他セグメントの売上高は、国内は979億円（前年同期比3.0%減）、海外は241億円（同6.6%増）となり、全体では1,221億円（同1.2%減）となりました。営業利益は67億円（同17億円増）となりました。

なお、平成15年度中間期末より富士通リース株式会社が連結子会社から持分法適用関連会社に移行したことにより、金融セグメントはなくなりました。

2. 所在地別セグメント

a. 日本

日本においては、第3世代携帯電話基地局やデジタルAV機器向けロジックLSIの売上が好調で、売上高は1兆6,461億円（前年同期比1.8%増）となりました。営業利益は526億円（同364億円増）となりました。

b. 欧州

欧州においては、前年度に政府系アウトソーシング商談を連続して受注した英国子会社の業績が大幅に改善し、売上高は2,740億円（前年同期比12.2%増）となりました。営業利益は20億円（同40億円増）となりました。

c. 米州

米州においては、半導体等の売上が増加し、売上高は1,366億円（前年同期比16.6%増）となりました。営業利益は前年度の事業構造改善の効果により21億円（同99億円増）となりました。

d. その他

アジアを含むその他の地域においては、売上高は1,632億円（前年同期比0.5%減）となりました。営業利益は、50億円（同1億円減）となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当中間連結会計期間中の営業活動によるキャッシュ・フローは、501億円のプラスとなり、本業による利益が運転資金の必要額を上回りました。前年同期比では利益の改善により127億円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資のための支出であり、556億円のマイナスとなりました。前年同期は投資有価証券売却収入が855億円あったため、投資活動によるキャッシュ・フローの前年同期比は253億円の支出増となりました。この結果、フリー・キャッシュ・フローは54億円のマイナスとなりました。

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、手許資金を取り崩して社債の償還などに充当したため、1,848億円のマイナスとなりました。

なお、前中間連結会計期間のキャッシュ・フローと当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの比較は、次のとおりであります。

	平成15年度中間期 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) (億円)	平成16年度中間期 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日) (億円)
(A) 営業キャッシュ・フロー	374	501
(B) 投資キャッシュ・フロー	△303	△556
(C) フリー・キャッシュ・フロー (A) + (B)	70	△54
(D) 財務キャッシュ・フロー	△506	△1,848
(E) キャッシュ・フロー計 (C) + (D)	△435	△1,902

2【生産、受注及び販売の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）の生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構造、形式等は必ずしも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品も多く、事業の種類別セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。

このため生産、受注及び販売の状況については、「1. 業績等の概要」における各事業の種類別セグメント業績に関連付けて示しております。

3【対処すべき課題】

国内外におけるIT投資は緩やかに増加しておりますが、サービス/製品の価格低下や競争激化等により、当社グループを取り巻く環境は、今後も厳しく推移すると考えております。厳しい環境下においても、確実な利益成長を実現できる収益力を目指します。また、お客様との信頼関係をさらに強固なものとするため、さらなる財務体質の強化に取り組んでまいります。

当社グループは、「お客様起点」「納期と品質」「スピード」といった基本姿勢を徹底するとともに、平成16年度より以下の4つのチャレンジ項目を掲げ、全社をあげて取り組んでおります。

(1) 既存ビジネスの徹底した体質強化

設計、開発、製造、営業等のあらゆる場面において、品質向上、原価低減、スピードアップに取り組んでおります。ものづくりにおいては、生産革新運動の全社展開を継続して進めるとともに、ソフトウェア開発において、総合システム開発体系「SDAS」の適用を推進することで、品質向上、原価低減、スピードアップを追求してまいります。加えて、商談監査を行うビジネスリスクマネジメント室の体制を強化するなど、リスク管理強化に取り組んでおり、今後も進行基準の適用に向け、プロジェクトの可視化を進め、管理をより一層強化してまいります。

また、サーバやストレージ、ミドルウェア等のプロダクトの差異化を図り、全社で拡販運動を推進するとともに、システム全体の信頼性を高めたIT基盤「TRIOLE」の展開を強化しております。併せて、今後成長の見込まれるアウトソーシングサービスの一層の拡大を図ってまいります。

(2) 新しい事業を創り、育てる

ユビキタス関連市場および海外市場への取り組みを強化してまいります。ユビキタス関連市場においては、当社の持つ最先端の電子デバイス、プロダクト、ソフトウェア、サービスの連携によるトータルなソリューションの提供により、他社との差異化を図ります。

海外市場においては、欧州、北米、アジア・豪州の各地域におけるグループ会社の機能を見直し、再編を実施いたしました。IT基盤「TRIOLE」の海外展開を進めており、“TRIOLE Integration Centre”の英国での設立を皮切りに、高信頼システムの構築・運用のモデル化と先進事例の共有をグローバルに推進してまいります。併せて、サーバ事業におけるサン・マイクロシステムズ社やマイクロソフト社との提携など、海外ビジネスの拡大に向けて、グローバルパートナーとの戦略提携を進めております。

また、電子デバイス分野においては、平成17年4月に予定している稼働に向けて、最先端技術の90/65ナノメートルに対応した300mm大口径ウェハ採用のロジックLSI量産ラインを、計画どおり三重工場敷地内に建設中です。

(3) フォーマーシヨンの革新

お客様対応のスピード向上およびITライフサイクル全体のシームレスなサポートを実現するため、事業・機能の重複・競合をなくし、お客様にわかりやすい組織をつくることを基本的な考えとして、フォーマーシヨンの革新に取り組んでおります。具体的には、保守サポート体制の強化、並びに運用サービスの拡大を図るため、富士通サポートアンドサービス㈱の完全子会社化を実施いたしました。さらに、SE部門と営業部門の組織一体化を6月に実施し、業種別・地域別の体制へ再編するとともに、地域SE会社の再編など、地域および中堅企業のお客様対応の強化に向けたフォーマーシヨンの見直しを順次進めております。今後も、お客様対応強化とスピード向上を実現するため、本体とグループ会社の関係及びグループ会社間関係等、フォーマーシヨンの見直しを引き続き進めてまいります。

(4) マネージメントシステムの革新

当社の制度・仕組みについても見直しを進めております。研究開発については、より事業との関連を強化するために研究テーマの決定プロセスの見直しや知的財産権戦略の強化を進めてまいります。また、人事制度についても、社員が能力を最大限に発揮できる仕組みを実現する改革に継続して取り組むとともに、責任の明確化と権限の委譲などを含めた組織のあり方について見直しを進めております。

これらの施策を推進する基本として、当社の目標、指針、行動規範を定めた「The FUJITSU Way」の浸透、定着を一層加速するために、7月に経営会議直属の委員会として「The FUJITSU Way推進委員会」を新たに設置し、実行組織として「The FUJITSU Way推進室」を設置いたしました。

以上のような課題を不断の努力を積み重ねることにより解決し、お客様に信頼されるパートナーとなり、豊かで活力のあるネットワーク社会づくりに貢献できるグローバルな企業としてお客様や社会から信頼されるよう一層の自己革新を図ってまいります。

4【経営上の重要な契約等】

(1) 株式交換契約

当中間連結会計期間において、当社と富士通サポートアンドサービス株式会社（以下「F s a s」）は、保守サービスの体制強化と運用サービスを核としたビジネスの拡大を図るため、平成16年5月17日に株式交換契約を締結いたしました。当該契約の内容は以下のとおりです。

① 株式交換の内容

当社を完全親会社とし、F s a s を完全子会社とする株式交換

② 株式交換の日

平成16年10月1日

③ 株式交換の方法

株式交換期日の前日（平成16年9月30日）現在のF s a s の株主名簿記載の株主に対して、当社の普通株式68,054,400株を新たに発行し、割当交付する。ただし、当社の保有するF s a s の普通株式32,000,000株については、当社の普通株式は割り当てないものとする。

④ 株式交換の比率

	当社	F s a s
株式交換比率	1	2.72

⑤ F s a s の概要（平成16年9月30日現在）

代表者 代表取締役社長 前山 淳次

資本金 9,401百万円

住所 東京都品川区南大井六丁目26番1号

事業内容 情報システムの企画・設計、導入・構築、運用・保守

業績 平成16年3月期（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

売上高 2,271億円

営業利益 90億円

経常利益 77億円

当期純利益 64億円

(2) 合弁契約及びその他の契約

契約会社名	相手方	国名	契約内容
富士通株式会社（当社）	Sun Microsystems, Inc.	米国	平成16年5月31日、左記会社との間で、次期SPARC/Solarisサーバ製品の開発・製造・販売に関する協力関係を規定する諸契約を締結いたしました。

5【研究開発活動】

当社グループ（当社及び連結子会社）は、最先端技術の開発、高付加価値製品の開発を目指し、基礎から応用に至る幅広い研究開発活動を通じて自主技術の創造を推進しております。

当中間連結会計期間における各セグメント別の主な研究内容及び研究開発費は次のとおりであります。なお、研究開発費については、下記のセグメント以外のその他のセグメントの研究開発費3,609百万円のほか、(株)富士通研究所をはじめ、各セグメントに配賦できない基礎研究費用等13,315百万円が含まれており、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は125,905百万円であります。

ソフトウェア・サービスセグメントに係る分野では、在庫管理やPOSシステム、SCMシステムなど小売りや流通、製造業など様々な業種で利用が期待される電子タグ技術を開発いたしました。この技術は、無線やメモリの機能を内蔵した電子タグを物品に貼付し、無線通信を利用して非接触で物品の認識を行う技術です。従来、タグとリーダー/ライタ装置との通信距離が短かったため応用が限られ、また、金属や水分を含むものに電子タグを貼り付けると通信性能が低下するなどの課題がありました。今回、UHF帯の無線を利用し、総務省で制度化される予定の国内技術基準に準拠したリーダー/ライタ装置や、通信性能やセキュリティ機能を強化する独自技術、金属や水分を含むものに貼り付けても高い通信性能が得られるタグアンテナ技術などの開発により、機能・動作の有効性を確認いたしました。これにより、より離れた場所からでも物品を認識できることから応用できるサービスが広がります。

ソフトウェア・サービスセグメントに係る研究開発費は31,384百万円であります。

プラットフォームの分野では、ネットワークサービスを安定に運用する管理技術として、IPパケットの流れを分析し、ネットワークの性能劣化の原因を探索する技術を開発いたしました。これまで、ネットワークサービスを安定に運用する方式として、送受信データ量や障害などの情報を管理システムが収集し、集中管理をする方法がとられてきました。しかし、原因が多岐にわたることから集中管理だけでは十分な対応ができなくなっていました。本技術では、データを運ぶIPパケットの流れを観測し、レスポンス悪化などの問題を定量的に把握すると共に、検査用のパケットを投入して性能劣化の原因と箇所を離れた場所から具体的に特定します。これにより、異常ルータの検出や不良な回線の特定など、従来の方法では発見できなかった原因となる具体的な装置までも迅速に探索でき、問題発生時の早期解決と運用管理コストの削減が実現できます。

プラットフォームセグメントに係る研究開発費は53,291百万円であります。

インターネット上での電子商取引の普及に伴い、より安全性の高い通信技術に対する需要が高まっています。これを受けて、電子デバイスを含む先端テクノロジーの分野では、極めて安全性が高く究極の暗号通信といわれる量子暗号を実現するキー技術として、世界で初めて1.3ミクロン帯における単一光子の発生に成功いたしました。これまで、実用的な光通信波長帯（1.3～1.55ミクロン帯）で単一光子を発生することができませんでしたが、単一光子を発生・計測するシステムを開発することにより実現いたしました。これにより、従来、毎秒数100ビットでしかデータ転送できなかった量子暗号通信の速度を、400倍以上高速化できる可能性が拓け、実用化に向けて大きく前進いたしました。本技術は、文部科学省ITプログラムとして実施され、東京大学先端科学技術研究センターとの共同研究によるものです。また、使用した半導体結晶は物質・材料研究機構ナノマテリアル研究所との共同研究によるものです。

電子デバイスセグメントに係る研究開発費は24,306百万円であります。

ロボットの分野では、オフィスや商業施設などにおいて、お客様の案内や物品の搬送など、実用的なサービスを提供するサービスロボットを開発いたしました。新規に開発した3次元視覚処理システムにより、障害物を避けながら自律的に移動したり、物を認識して掴むことができます。また音声認識や発話の技術、ディスプレイ表示などにより簡単な指示を理解し、作業の実行や情報の提供ができます。サービスロボットは、オフィスや公共施設などの人と共存する様々な場所で、新たなサービスビジネスを展開することができます。